



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) DE 10 2004 030 388 A1 2006.01.26

(12)

Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2004 030 388.6

(22) Anmeldetag: 23.06.2004

(43) Offenlegungstag: 26.01.2006

(51) Int. Cl. ⁸: **H05K 3/22** (2006.01)

H05K 1/09 (2006.01)

H01B 1/12 (2006.01)

(71) Anmelder:
Ormecon GmbH, 22949 Ammersbek, DE

(74) Vertreter:
Uexküll & Stolberg, 22607 Hamburg

(72) Erfinder:
Weßling, Bernhard, Dr., 22941 Bargteheide, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:

DE 102 34 363 A1

DE 43 33 127 A1

US 56 45 890

US 55 32 025

EP 08 07 190 B1

EP 06 56 958 B1

EP 04 07 492 B1

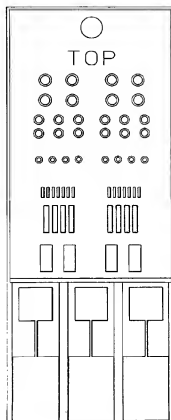
J.Posdorfer, B.Wessling, "Oxidation of copper in
the presence of the Organic Metal polyaniline",
In: ICSM 2000 (Bad Gastein / Austria), 15.-21.
July 2000;

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: **Artikel mit einer Beschichtung von elektrisch leitfähigem Polymer und Verfahren zu deren Herstellung**

(57) Zusammenfassung: Beschichteter Artikel, der (i) mindestens eine nicht elektrisch leitende Basisschicht, (ii) mindestens eine Schicht aus Kupfer und/oder einer Kupferlegierung und (iii) eine Schicht, die mindestens ein elektrisch leitfähiges Polymer enthält, aufweist. Der Artikel ist dadurch gekennzeichnet, daß die Kupfer- oder Kupferlegierungsschicht (ii) zwischen der Basisschicht (i) und der das leitfähige Polymer enthaltenden Schicht (iii) angeordnet ist.



Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft beschichtete Artikel, die eine Schicht aus Kupfer oder einer Kupferlegierung und eine Schicht eines elektrisch leitfähigen Polymers enthalten und die sich insbesondere als Leiterplatten oder zur Herstellung von Leiterplatten eignen.

[0002] Kupfer ist eines der am weitesten verbreiteten metallischen Werkstoffe unserer Zeit. Obwohl Kupfer ein Halbedelmetall ist, ist dieser Werkstoff leicht oxidierbar, was sich oftmals negativ auf seine Gebrauchseigenschaften auswirkt. Dies äußert sich nicht nur optisch, sondern hat insbesondere praktische technische Nachteile. Besondere Probleme treten bei der Beschichtung von Leiterplatten, die anschließend in Lötprozessen bestückt werden, Kupferdrähten, die als elektrische Leiter verwendet werden, oder Kupferrohren auf. Feinteilige Kupferpulver können praktisch nicht ohne Oxidationsschutz hergestellt und verwendet werden.

[0003] Kupfer wird normalerweise nicht wie Eisen und Stahl mit Schutzüberzügen versehen, die im Fall von Lacken häufig in mehreren Schichten aufgetragen werden müssen. Vielmehr werden als Schutz gegen Kupferkorrosion überwiegend Stoffe eingesetzt, die mit dem Kupfer Komplexe bilden, wie beispielsweise Imidazole, Benzimidazole, Benzotriazole, Thioharnstoff und Imidazol-2-thion.

[0004] Derartige organische Komplexbildner sind zwar preiswert und einfach zu verarbeiten, zeigen aber dennoch eine Reihe von Nachteilen. So enthalten Formulierungen mit Imidazolen oder Benzimidazolen oftmals Ameisensäure und ggf. andere organische Säuren, die unangenehm riechen, ätzend sind und toxikologische Nachteile haben. Zudem ist die thermische Stabilität niedrig.

[0005] Bei der Herstellung von Leiterplatten, beschichtet man Kupfer zum Schutz vor Korrosion daher oft mit anderen Metallen, wie z.B. Gold, Silber oder Zinn, um die Lötbarkeit der Kupferkontakte und der verkupferten Bohrungen zu erhalten, die durch Oxidation innerhalb kürzester Zeit verloren geht.

Stand der Technik

[0006] Eine Übersicht über gebräuchliche lötfähige Endoberflächen und deren technische, ökonomische, ökologische und toxikologische Vor- und Nachteile findet sich in "Alternative Technologies for Surface Finishing – Cleaner Technology for Printed Wired Board Manufacturers", EPA, Office of Pollution Prevention and Toxics, Juni 2001, EPA 744-R-01-001.

[0007] Metallische Beschichtungen sind im allgemeinen für Leiterplatten gut geeignet, weisen jedoch ebenfalls eine Reihe von Nachteilen auf. Beschichtungen mit Gold sind nicht nur auf Grund des hohen Goldpreises teuer, sondern erfordern darüber hinaus spezielle Verfahren zum Aufbringen der Goldschicht. Beispielsweise kann Gold chemisch nicht in sogenannten Horizontalanlagen sondern nur in Vertikalanlagen aufgebracht werden, was zusätzlich hohe Verfahrenskosten verursacht.

[0008] Das Aufbringen von Silber ist schlecht reproduzierbar, und die erforderlichen Anlagen sind schwer einzustellen.

[0009] Zinn ist zwar insbesondere dann, wenn es mit Hilfe eines Organischen Metalls aufgebracht wird, wie beispielsweise bei dem ORMECON CSN-Verfahren der Ormecon GmbH, in technischer und ökonomischer Sicht zufriedenstellend, allerdings erfordert seine Abscheidung in der Regel mehrere Minuten, was entsprechend groß dimensionierte Anlagen erforderlich macht, um einen hohen Durchsatz zu gewährleisten.

[0010] Aus der EP 0 807 190 B1 ist ein Verfahren zur Herstellung metallisierter Werkstoffe bekannt, bei dem der zu metallisierende Werkstoff zunächst mit einem intrinsisch leitfähigen Polymer beschichtet, das intrinsisch leitfähige Polymer dann durch Reduktion aktiviert und schließlich das Metall in nicht elektrochemischer Weise aufgebracht wird, indem der beschichtete Werkstoff mit einer Lösung von Ionen des Metalls in Kontakt gebracht wird. Das Verfahren eignet sich besonders zur Abscheidung von Zinn auf Kupfer aber auch zur Metallisierung von Kunststoffoberflächen.

[0011] Die EP 0 407 492 B1 offenbart ein Verfahren zur Beschichtung von Substraten mit dünnen Schichten aus intrinsisch leitfähigen Polymeren, bei dem beispielsweise Polyanilin aus einer metastabilen Dispersion stromlos auf einem Substrat abgeschieden wird.

[0012] Als Substrate werden unter anderem Metalle wie Gold, Platin, Eisen, Stahl, Kupfer und Aluminium ge-

nannt. Die Schichten aus leitfähigem Polymer führen bei Metallen, die unedler als Silber sind, zur Ausbildung von Metalloxydschichten und sollen sich unter anderem zum Korrosionsschutz eignen.

[0013] Die EP 0 656 958 B1 betrifft ein Verfahren zur Herstellung korrosionsgeschützter metallischer Werkstoffe wie Eisen, Stahl, Kupfer und Aluminium, bei dem eine Schicht eines intrinsisch leitfähigen Polymers auf einen metallischen Werkstoff aufgebracht und anschließend der beschichtete Werkstoff mit sauerstoffhaltigem Wasser passiviert wird. Es wird darauf hingewiesen, daß das Aufbringen des leitfähigen Polymers allein keinen ausreichenden Korrosionsschutz gewährleistet, und der metallische Werkstoff wird daher nach der Passivierung vorzugsweise mit einem Korrosionsschutzüberzug versehen. Das leitfähige Polymer kann vor dem Aufbringen des Korrosionsschutzüberzugs wieder entfernt werden.

Aufgabenstellung

[0014] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, beschichtete Artikel zur Verfügung zu stellen, die eine Schicht aus Kupfer oder einer Kupferlegierung enthalten, bei denen das Kupfer oder die Kupferlegierung einerseits wirkungsvoll gegen Oxidation geschützt ist und andererseits ein Verlust der Lötbarkeit des Kupfers oder der Kupferlegierung bei der Lagerung verhindert wird.

[0015] Diese Aufgabe wird durch einen beschichteten Artikel gelöst, der

- (i) mindestens eine nicht elektrisch leitende Basisschicht,
- (ii) mindestens eine Schicht aus Kupfer und/oder einer Kupferlegierung, und
- (iii) eine Schicht, die mindestens ein elektrisch leitfähiges Polymer enthält, aufweist.

[0016] Der Artikel ist dadurch gekennzeichnet, daß die Kupfer- oder Kupferlegierungsschicht (ii) zwischen der Basisschicht (i) und der das leitfähige Polymer enthaltenden Schicht (iii) angeordnet ist.

[0017] Die erfindungsgemäße Lösung ist insofern überraschend, als im Hinblick auf den Stand der Technik nicht zu erwarten war, daß allein die Beschichtung mit einem elektrisch leitfähigem Polymer einen wirksamen Schutz von Kupfer vor Korrosion erlauben würde. Erst recht war keine Verbesserung hinsichtlich der Erhaltung der Lötbarkeit von Kupfer und Kupferlegierungen zu erwarten. Gemäß dem Stand der Technik bewirken Schichten aus leitfähigem Polymer die Ausbildung dünner Metalloxydschichten auf der Oberfläche von Metallen, die unedler als Silber sind. Die Ausbildung solcher Oxidschichten wird jedoch maßgeblich für den Verlust der Lötbarkeit von Kupfer verantwortlich gemacht.

[0018] Die Schichtdicke der Schicht (iii) liegt vorzugsweise unterhalb von 1 µm, was der allgemeinen Erwartung widerspricht, wonach man mit dickeren Schichten einen größeren Effekt erzielen würde. Vorzugsweise beträgt die Dicke der Schicht (iii) mindestens ca. 10 nm. Besonders bevorzugt sind Schichtstärken unterhalb von 500 nm, besonders bevorzugt unterhalb von 200 nm.

[0019] Die Schicht enthält mindestens ein elektrisch leitfähiges Polymer, das vorzugsweise in Form eines Organischen Metalls eingesetzt wird. Kombinationen verschiedener Stoffe aus dieser Stoffklasse können verwendet werden. Unter Polymeren werden im Rahmen dieser Erfindung, wenn nicht anders angegeben, organische Polymere verstanden.

[0020] Unter elektrisch leitfähigen Polymeren oder leitfähigen Polymeren, die auch "intrinsisch leitfähige Polymere" genannt werden, werden Stoffe verstanden, die aus niedermolekularen Verbindungen (Monomeren) aufgebaut sind, durch Polymerisation mindestens oligomer sind, also mindestens 3 Monomereinheiten enthalten, die durch chemische Bindung verknüpft sind, im neutralen (nicht leitfähigen) Zustand ein konjugiertes π -Elektronensystem aufweisen und durch Oxidation, Reduktion oder Protonierung (was oftmals als "dotieren" bezeichnet wird) in eine ionische Form überführt werden können, die leitfähig ist. Die Leitfähigkeit beträgt mindestens 10^{-7} S/cm und liegt üblicherweise unter 10^5 S/cm.

[0021] Als Dotierungsmittel werden im Falle der Dotierung durch Oxidation z.B. Jod, Peroxide, Lewis- und Protonensäuren oder im Falle der Dotierung durch Reduktion z.B. Natrium, Kalium, Calcium eingesetzt.

[0022] Leitfähige Polymere können chemisch außerordentlich unterschiedlich zusammengesetzt sein. Als Monomere haben sich z.B. Acetylen, Benzol, Naphthalin, Pyrrol, Anilin, Thiophen, Phenylensulfid, peri-Naphthalin und andere, sowie deren Derivate, wie Sulfo-Anilin, Ethylenedioxythiophen, Thieno-thiophen und andere, sowie deren Alkyl- oder Alkoxy-Derivate oder Derivate mit anderen Seitengruppen, wie Sulfonat-, Phenyl- und andere Seitengruppen, bewährt. Es können auch Kombinationen der oben genannten Monomere als Monomer

eingesetzt werden. Dabei werden z.B. Anilin und Phenylensulfid verknüpft und diese A-B-Dimere dann als Monomere eingesetzt. Je nach Zielsetzung können z.B. Pyrrol, Thiophen oder Alkylthiophene, Ethylendioxythiophen, Thieno-thiophen, Anilin, Phenylensulfid und andere miteinander zu A-B-Strukturen verbunden und diese dann zu Oligomeren oder Polymeren umgesetzt werden.

[0023] Die meisten leitfähigen Polymere weisen einen mehr oder weniger starken Anstieg der Leitfähigkeit mit steigender Temperatur auf, was sie als nicht-metallische Leiter ausweist. Andere leitfähige Polymere zeigen zumindest in einem Temperaturbereich nahe Raumtemperatur ein metallisches Verhalten insofern, als die Leitfähigkeit mit steigender Temperatur sinkt. Eine weitere Methode, metallisches Verhalten zu erkennen, besteht in der Auftragung der sogenannten "reduzierten Aktivierungsenergie" der Leitfähigkeit gegen die Temperatur bei niedrigen Temperaturen (bis nahe 0 K). Leiter mit einem metallischen Beitrag zur Leitfähigkeit zeigen eine positive Steigung der Kurve bei niedriger Temperatur. Solche Stoffe bezeichnet man als "organische Metalle".

[0024] Organische Metalle sind an sich bekannt. Gemäß Weißing et al., Eur. Phys. J. E 2, 2000, 207–210, kann der Übergang vom Zustand eines nicht-metallischen zu einem zumindest teilweise metallischen Leiter durch einen einstufigen Reib- bzw. Dispersionsvorgang nach vollendeter Synthese des intrinsisch leitfähigen Polymers bewirkt werden, dessen verfahrenstechnische Grundlage in der EP 0 700 573 A beschrieben wird. Hierbei wird durch den Dispersionsvorgang auch die Leitfähigkeit erhöht, ohne daß die chemische Zusammensetzung des verwendeten leitfähigen Polymeren wesentlich verändert wird.

[0025] Bevorzugte intrinsisch leitfähige Polymere sind die oben genannten. Insbesondere können als Beispiele genannt werden: Polyanilin (PAni), Polythiophen (PTh), Poly(3,4-ethyldioxythiophene) (PEDT), Polydiacetylen, Polyacetylen (PAC), Polypyrrol (PPy), Polyisothianaphthen (PITN), Polyheteroarylenvinylene (PAV), wobei die Heteroarylen-Gruppe z.B. Thiophen, Furan oder Pyrrol sein kann, Poly-p-phenylene (PpP), Polypheylensulfid (PPS), Polyperinaphthalin (PPN), Polyphthalocyanin (PPC) u.a., sowie deren Derivate (die z.B. aus mit Seitenketten oder -gruppen substituierten Monomeren gebildet werden), deren Copolymere und deren physikalische Mischungen. Besonders bevorzugt sind Polyanilin (PAni), Polythiophen (PTh), Polypyrrol (PPy), Poly(3,4-ethyldioxythiophene) (PEDT), Polythieno-thiophen (PTT) und deren Derivate sowie Mischungen davon. Am meisten bevorzugt ist Polyanilin.

[0026] Die Schicht (iii) kann ausschließlich aus einem oder mehreren leitfähigen Polymeren und/oder Organischen Metallen bestehen oder Mischungen von einem oder mehreren leitfähigen Polymeren mit anderen Stoffen wie nicht elektrisch leitfähigen Komponenten enthalten. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform enthält die Schicht (iii) Polymerblends, also Mischungen von leitfähigem Polymer/Organischem Metall (oder einer Kombination von mehreren) mit elektrisch nicht leitfähigen Polymeren. Als nicht leitfähige Polymere eignen sich besonders wasserlösliche oder wasserdispersierbare Polymere, insbesondere Polystyrol/sulfonsäure, Polyacrylate, Polyvinylbutyrate, Polyvinylpyrrolidone, Polyvinylalkohole und Mischungen davon. Leitfähige und nicht leitfähige Polymere werden vorzugsweise im Verhältnis von 1 : 1,5 bis 1 : 20 eingesetzt.

[0027] Die Schicht (iii) kann auch weitere Additive enthalten, insbesondere Viskositätsregler, Verlaufshilfen, Trocknungshilfen, Glanzverbesserer, Mattierungsmittel und Mischungen davon, vorzugsweise in einer Konzentration von 0,01 bis 5 Gew.-% Additiv bezogen auf die Masse der Schicht (iii). Die Schicht (iii) enthält vorzugsweise 5 bis 98 Gew.-%, insbesondere 15 bis 40 Gew.-% leitfähiges Polymer, bezogen auf die Masse der Schicht (iii).

[0028] Es hat sich gezeigt, daß eine Kombination des/der leitfähigen Polymeren/Organischen Metalle mit solchen Komplex-Bildnern von Vorteil sein kann, die in Lage sind, Kupfer zu komplexieren. Bevorzugte Komplexbildner sind Imidazole, Benzimidazole oder vergleichbare Komplexbildner, wie Benzotriazole, Thioharnstoff, Imidazol-2-thione, und Mischungen davon, die sich durch eine relativ gute thermische Stabilität auszeichnen.

[0029] Als Basisschicht (i) sind alle in der Leiterplattentechnik eingesetzten Materialien geeignet, insbesondere Epoxide und Epoxidcomposite, Teflon, Cyanatester, Keramik, Cellulose und Cellulosecomposite, wie beispielsweise Pappe, auf diesen Stoffen basierende Materialien sowie flexible Basisschichten z.B. auf Basis von Polyimid. Die Basisschicht weist vorzugsweise eine Schichtdicke von 0,1 bis 3 mm auf.

[0030] Die Kupferschicht oder Kupferlegierungsschicht (ii) hat vorzugsweise eine Dicke von 5 bis 210 µm, insbesondere 15 bis 35 µm.

[0031] Zwischen der Schicht (ii) und der Schicht (iii) kann eine weitere Metall- oder Legierungsschicht (iv) an-

geordnet werden. Die Schicht (iv) enthält vorzugsweise Silber, Zinn, Gold, Palladium oder Platin. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform enthält die Schicht (iv) überwiegend, d.h. zu mehr als 50 Gew.-% bezogen auf die Masse der Schicht (iv) eines oder mehrere der genannten Metalle. Die genannten Metalle können insbesondere als Legierung mit Kupfer vorliegen. Gemäß einer anderen bevorzugten Ausführungsform besteht die Schicht (iv) ausschließlich aus den genannten Metallen, entweder in reiner Form oder in Form einer Legierung. Die Schicht (iv) weist vorzugsweise eine Schichtdicke von 10 bis 800 nm auf. Neben dem Metall oder der Legierung kann die Schicht (iv) organische Komponenten enthalten, in einer Konzentration von vorzugsweise 1 bis 80 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmasse der Schicht (iv) (Metallanteil 20 bis 99 Gew.-%). Bevorzugte organische Komponenten sind leitfähige Polymere bzw. organische Metalle, oder organische Kupferkomplexbildner wie Thioharnstoff, Benzotriazole.

[0032] Die erfindungsgemäßen Artikel eignen sich besonders zur Herstellung von Leiterplatten, vorzugsweise handelt es sich bei den Artikeln um Leiterplatten, die auch als Platinen bezeichnet werden. Hierbei handelt es sich um der Montage elektrischer Bauelemente dienende, dünne Platten mit Löchern, durch die die Anschlüsse der Bauelemente zur weiteren Verlotung gesteckt werden.

[0033] Zur Herstellung der erfindungsgemäßen beschichteten Artikel und insbesondere von Leiterplatten (1) bringt man auf die Oberfläche einer Basisschicht eine Schicht aus Kupfer oder einer kupferhaltigen Legierung auf;
(2) strukturiert die in Schritt (1) hergestellte Schicht; und
(3) bringt auf die strukturierte Kupfer- oder Kupferlegierungsschicht eine Schicht auf, die mindestens ein elektrisch leitfähiges Polymer enthält.

[0034] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens wird die Kupfer- oder Kupferlegierungsschicht (ii) im Anschluß an Schritt (1) entfettet und gereinigt. Hierzu werden die Artikel vorzugsweise mit handelsüblichen, sauren Reinigern behandelt. Bevorzugt sind Reiniger auf der Basis von Schwefelsäure und Zitronensäure, wie z.B. der Reiniger ACL 7001 der Ormecon GmbH. Die Artikel werden vorzugsweise für etwa 2 Minuten bei 45 °C in dem Reinigungsbad belassen und anschließend mit Wasser gewaschen.

[0035] Außerdem ist es bevorzugt, die Kupfer- oder Kupferlegierungsschicht (ii) im Anschluß an Schritt (1) oder nach der Reinigung oxidativ vorzubehandeln, beispielsweise durch Ätzen der Oberfläche mit H₂O₂ oder anorganischen Peroxiden. Geeignete Ätzlösungen sind kommerziell erhältlich, wie beispielsweise die Wasserstoffperoxidhaltige Lösung Etch 7000 der Ormecon GmbH. Die Artikel werden vorzugsweise für etwa 2 Minuten bei 30 °C in der Ätzlösung belassen.

[0036] Die in Schritt (1) hergestellte Schicht wird vorzugsweise mit lithographischen oder Ätzprozessen strukturiert, womit die Leiterbahnstruktur erzeugt wird.

[0037] Die Durchführung der einzelnen Schritte des obigen Verfahrens ist dem Fachmann an sich bekannt. Vorzugsweise wird die Schicht (iii) auf den Artikel aufgebracht, indem dieser, nach dem Spülen mit Wasser, mit einer Dispersion des oder der leitfähigen Polymeren bzw. Organischen Metalle in einem bei Raumtemperatur flüssigen Dispersionsmittel behandelt wird, beispielsweise durch Eintauchen des Artikels in die Dispersion oder durch Aufbringen derselben auf den Artikel. Das oder die elektrisch leitfähigen Polymere sind vorzugsweise in kolloidaler Form in dem Dispersionsmedium enthalten. Vorzugsweise wird der Artikel für etwa 1 Minute bei Raumtemperatur mit der Dispersion kontaktiert. Zusätzliche Komponenten, wie nicht elektrisch leitfähige Polymere und Additive können in dem Dispersionsmedium gelöst sein oder ebenfalls kolloidal darin vorliegen. Als Dispersionsmedien eignen sich organische Lösemittel, vorzugsweise mit Wasser mischbare organische Lösemittel, Wasser und Mischungen davon. Bevorzugte mit Wasser mischbare Lösemittel sind Alkohole, insbesondere Alkohole mit einem Siedepunkt von mehr als 100 °C und vorzugsweise unter 250 °C. Nach dem Aufbringen der Dispersion auf den Artikel wird dieser schonend getrocknet und ggf. weitere Dispersion aufgebracht, bis die gewünschte Schichtdicke erreicht ist. Die Herstellung und Anwendung zur Beschichtung geeigneter Dispersionen ist aus dem Stand der Technik bekannt, vgl. beispielsweise EP 0 407 492 B1.

[0038] Als Dispersionsmedium sind Wasser und wäßrige Lösemittel bevorzugt. Diese sind nicht nur im Hinblick auf Emissionen vorteilhaft, es wurde auch gefunden, daß Wasser und wäßrige Lösungsmittel bessere Ergebnisse erbringen. Dies war insofern überraschend, als Oxidationsvorgänge auf Kupfer in wäßrigem Milieu besonders schnell ablaufen. Ein weiterer Vorteil liegt darin, daß Lötstoplance nicht benetzt werden. Mit Lötstoplance werden die Bereiche der Leiterplatte abgedeckt, die beim Bestückungsprozeß nicht vom Lot benetzt werden dürfen. Der Lötstoplack sollte nicht mit dem leitfähigen Polymer benetzt werden, da dieses sonst Kurzschlüsse zwischen den Kupferflächen bewirken würde.

[0039] Vorzugsweise werden Dispersionen verwendet, die keine Ameisensäure enthalten, andere Säuren und/oder Puffer können jedoch in den Dispersionen enthalten sein.

[0040] Besonders geeignete Dispersionen sind kommerziell erhältlich, beispielsweise Dispersionen auf der Basis von Polyanilin, wie Dispersionen von Polyanilin-Polystyrolsulfonsäure-Blends in Wasser, z.B. das Produkt D 1012 der Ormecon GmbH, und Dispersionen von Polyanilin-Polyvinylpyrrolidon in Wasser, z.B. das Produkt D 1021 der Ormecon GmbH.

[0041] Die erfindungsgemäßen beschichteten Artikel zeichnen sich insbesondere dadurch aus, daß sie sich auch nach längerer Lagerung nicht nur gut löten lassen sondern auch mehrfach lötfähig sind, d.h. in mehrstufigen Lötprozessen, sogenannten reflow-Prozessen, eingesetzt werden können. In dieser Hinsicht konnte durch die erfindungsgemäßen beschichteten Artikel eine deutliche Annäherung an Leiterplatten mit metallischen Endoberflächen erzielt werden, die bis zu 12 Monate gelagert werden können, ohne ihre Lötfähigkeit einzubüßen, und die nach der Lagerung mehrfach gelötet werden können. Im Gegensatz dazu sind herkömmliche Leiterplatten, die allein mit Kupfer komplexierenden Mitteln zur Aufrechterhaltung der Lötfähigkeit behandelt wurden, sogenannte „OSP“ (Organic Solderability Preservative), in der Regel schon nach einer Lagerung von nur 3 bis 6 Monaten nicht mehr lötfähig, geschweige denn für Reflow-Prozesse geeignet. Die Leiterplatten werden als für Reflow-Prozesse besonders geeignet angesehen, wenn der Lötwinkel kleiner als 90°, vorzugsweise kleiner als 80° und insbesondere 60° oder kleiner ist. Als OSPs werden meist saure, wäßrige Formulierungen auf der Basis von z.B. Benzotriazolen eingesetzt, die Ameisensäure und/oder Essigsäure enthalten.

Ausführungsbeispiel

[0042] Im Folgenden wird die Erfindung anhand einer Figur und von nicht einschränkenden Ausführungsbeispielen weiter erläutern, wobei

[0043] Fig. 1 eine Leiterplatte mit einem Testdesign zeigt.

Ausführungsbeispiele

Beispiele 1 bis 2: Herstellung beschichteter Leiterplatten

[0044] Leiterplatten aus Epoxidharz-Composite wurden unter Verwendung eines handelsüblichen Reinigers auf der Basis von Schwefelsäure und Zitronensäure (ACL 7001, Ormecon GmbH) in einem Reinigungsbad für 2 Minuten bei 45 °C gereinigt und entfettet. Die verwendeten Leiterplatten hatten ein Testdesign (siehe Fig. 1), das mit Prüfinstituten und Leiterplattenherstellern abgestimmt und realen Leiterplattenstrukturen nachempfunden ist. Diese Platten erlauben die Messung und Beurteilung der Lötfähigkeit. Anschließend wurden die Leiterplatten bei Raumtemperatur mit Leitungswasser gespült und danach für 2 Minuten bei 30 °C mit einer H₂O₂ enthaltenden Ätzlösung (Etch 7000, Ormecon GmbH) behandelt. Nach dem Ätzen wurden die Platten erneut bei Raumtemperatur mit Leitungswasser gespült und dann mit den in Tabelle 1 aufgeführten leitfähigen organischen Polymeren beschichtet. Hierzu wurden die Platten bei Raumtemperatur für 1 Minute in eine wäßrige Dispersion des jeweiligen Polymers eingetaucht. Danach wurden die Leiterplatten bei 45 bis 75 °C getrocknet

Tabelle 1

Zur Beschichtung der Platten eingesetzte Polymere

Beispiel	leitfähiges Polymer
1	Polyanilin-Polypyrrolidon-Blend ¹⁾
2	Polyanilin-Polypyrrolidon-Blend ¹⁾ mit Zusatz einer Kupferkomplexbildners ²⁾

¹⁾ D 1021, Ormecon GmbH

²⁾ Benzotriazol (2 MZA, Fa. Shikoku)

[0045] Die Dispersion 1 enthielt 1,25 Gew.-% und die Dispersion 2 1,25 Gew.-% Festkörper, wobei in Disper-

sion 2 der Festkörperanteile 6 Gew.-% des Kupferkomplexbildners bezogen auf die Masse des Festkörperanteils enthielt.

Beispiele 3 und 4: Herstellung beschichteter Leiterplatten (Vergleich)

[0046] Analog zu den Beispielen 1 bis 2 wurden Leiterplatten gemäß den jeweiligen Anwendungsvorschriften mit handelsüblichen Mitteln auf der Basis von Benzotriazol beschichtet (Glicot Tough Ace F2 (LX); Firma Shikoku, Japan (Beispiel 3) und Entek Plus Cu 106 A, Firma Enthone OMI, Niederlande (Beispiel 4)).

Beispiel 5: Lötwinkelmessung

[0047] Ein Teil der in den Beispielen 1 bis 4 hergestellten Leiterplatten wurde einem beschleunigten Alterungsverfahren unterworfen, indem einige Platten für 1 Stunde bei 100 °C und andere für 4 Stunden bei 155 °C gelagert wurden. von den frisch hergestellten und den bei 100 °C bzw. 155 °C gealterten Platten wurde mit einem handelsüblichen Menisographen (Typ ST 60, Fa. Metronelec) der Lötwinkel (Benetzungswinkel; gemäß der Norm NF A 89 400 P bzw. ANSI-J-STD 003 I.E.C. 68-2-89) ermittelt. Das Gerät mißt die Benetzungskraft über die Zeit und rechnet diese nach üblichen Verfahren in Lötwinkel um (siehe Handbuch). Der Lötwinkel wurde jeweils ohne, nach zwei 2 und nach 3 reflow-Zyklen gemessen. Die reflow-Zyklen dienen der Simulation wiederholter Lötvorgänge und wurden in einem Hot-Air/Quartz Reflow Oven HA 06 (Fa. C.I.F./Athelec, Frankreich) durchgeführt, der Mehrfachlötungen mit Temperaturprofilen simuliert. Ein reflow Zyklus umfaßte eine erste Heizstufe von 140 s bei 190 °C (Vorheizstufe) und eine zweite Heizstufe von 150 s bei 260 °C (Schmelzstufe).

[0048] Die Ergebnisse der Lötwinkelmessungen sind in Tabelle 2 gezeigt.

Tabelle 2

Ergebnisse der Lötwinkelmessung¹⁾

Bsp.	Frisch hergestellte Platten			1 h Alterung bei 100 °C			4 h Alterung bei 155 °C		
	0 RC	2 RC	3 RC	0 RC	2 RC	3 RC	0 RC	2 RC	3 RC
1	10	61	61	22	68	76	49	74	77
2	20	65	82	24	50	73	33	70	76
3*	29	68	99	30	39	91	70	102	93
4*	21	51	84	21	50	75	52	83	96

¹⁾ Lötwinkel in ° nach 2 Sekunden, gemessen mit bleihaltigem Lot (Sn/Pb = 60/40)

RC Reflow cyclen (190 °C/140 s und 260 °C/150 s)

* Vergleichsversuch

[0049] Die Ergebnisse in Tabelle 2 zeigen, daß die Lötwinkel bei zunehmender Alterung und insbesondere bei wiederholtem Löten ansteigen. Während die Lötwinkel nach der zweiten Alterungsstufe ohne vorherige reflow-Behandlung für die erfindungsgemäßen Leiterplatten und die Vergleichsleiterplatten zum Teil noch in einer vergleichbaren Größenordnung liegen, werden für die Vergleichsplatten nach zwei reflow-Zyklen relativ hohe Werte gemessen, die teilweise schon über dem kritischen Wert von 90° liegen (Beispiel 3). Nach drei reflow-Zyklen liegen die Lötwinkel beider Vergleichsplatten mit 93° und 96° oberhalb von 90°, was eine schlechte Benetzung der Oberfläche und eine ungenügende Lötbarkeit anzeigt. Im Gegensatz dazu ist bei den erfindungsgemäßen Platten nach vierstündiger Lagerung bei 155 °C nur eine geringe Zunahme des Lötwinkels bei der Erhöhung der Zahl der reflow-Zyklen feststellbar, so daß diese Platten auch im gealterten Zustand ohne Einschränkung für wiederholte Lötvorgänge geeignet sind.

Patentansprüche

1. Beschichteter Artikel, der
 - (i) mindestens eine nicht elektrisch leitende Basisschicht,
 - (ii) mindestens eine Schicht aus Kupfer und/oder einer Kupferlegierung, und
 - (iii) eine Schicht, die mindestens ein elektrisch leitfähiges Polymer enthält,aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kupfer- oder Kupferlegierungsschicht (ii) zwischen der Basisschicht (i) und der das leitfähige Polymer enthaltenden Schicht (iii) angeordnet ist.
2. Beschichteter Artikel nach Anspruch 1, bei dem die Schicht (iii) eine Schichtdicke von 10 nm bis 1 µm aufweist.
3. Beschichteter Artikel nach Anspruch 2, bei dem die Schicht (iii) eine Schichtdicke von weniger als 500 nm aufweist.
4. Beschichteter Artikel nach Anspruch 3, bei dem die Schicht (iii) eine Schichtdicke von weniger als 200 nm aufweist.
5. Beschichteter Artikel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Schicht (iii) mindestens eine nicht elektrisch leitende Komponente und mindestens ein elektrisch leitfähiges Polymer enthält.
6. Beschichteter Artikel nach Anspruch 5, bei dem die Schicht (iii) 5 Gew.-% bis 98 Gew.-% elektrisch leitfähiges Polymer bezogen auf die Masse der Schicht (iii) enthält.
7. Beschichteter Artikel nach Anspruch 5 oder 6, bei dem die nicht elektrisch leitende Komponente ein Polymer ist.
8. Beschichteter Artikel nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei dem die Schicht (iii) mindestens einen Komplexbildner enthält.
9. Beschichteter Artikel nach Anspruch 8, bei dem der Komplexbildner aus Benzimidazolen, Imidazolen, Benzotriazolen, Thioharnstoff, Imidazol-2-thionen und Mischungen davon ausgewählt ist.
10. Beschichteter Artikel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das elektrisch leitende Polymer aus Polyanilin (PAni), Polythiophen (PTh), Polypyrrol (PPy), Poly(3,4-ethyldioxythiophene) (PEDT), Polythieno-thiophen (PTT), deren Derivaten und Mischungen davon ausgewählt ist.
11. Beschichteter Artikel nach einem der vorangehenden Ansprüche, bei dem die Basisschicht (i) Epoxid, Epoxidcomposit, Teflon, Cyanatester, Keramik, Cellulose, Cellulosecomposit, Pappe und/oder Polyimid enthält.
12. Beschichteter Artikel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Basisschicht (i) eine Schichtdicke von 0,1 bis 3 mm aufweist.
13. Beschichteter Artikel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Schicht (ii) eine Schichtdicke von 5 bis 210 µm aufweist.
14. Beschichteter Artikel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, der eine weitere Metall- oder Legierungsschicht (iv) enthält, die zwischen der Schicht (ii) und der Schicht (iii) angeordnet ist.
15. Beschichteter Artikel nach Anspruch 14, bei dem die Schicht (iv) Silber, Zinn, Gold, Palladium oder Platin enthält.
16. Beschichteter Artikel nach Anspruch 14 oder 15, bei dem die Schicht (iv) eine Schichtdicke von 10 bis 800 nm aufweist.
17. Beschichteter Artikel nach einem der vorhergehenden Ansprüche in Form einer Leiterplatte.
18. Verfahren zur Herstellung eines beschichteten Artikels gemäß einem der Ansprüche 1 bis 17, bei dem (1) man auf die Oberfläche einer Basisschicht eine Schicht aus Kupfer oder einer kupferhaltigen Legierung auf-

bringt,

(2) man die in Schritt (1) hergestellte Schicht strukturiert; und

(3) man auf die strukturierte Kupfer- oder Kupferlegierungsschicht eine Schicht aufbringt, die mindestens ein elektrisch leitfähiges Polymer enthält.

19. Verfahren nach Anspruch 18, bei dem man die Kupfer- oder Kupferlegierungsschicht (ii) im Anschluß an Schritt (1) einer Reinigung unterwirft.

20. Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, bei dem man die Kupfer- oder Kupferlegierungsschicht (ii) im Anschluß an Schritt (1) oder nach der Reinigung einer oxidativen Vorbehandlung unterwirft.

21. Verwendung einer Dispersion, die ein bei Raumtemperatur flüssiges Dispersionsmedium und ein elektrisch leitfähiges Polymer enthält, zur Verhinderung der Korrosion und/oder der Verhinderung eines Verlustes der Lötbarkeit von Leiterplatten.

22. Verwendung nach Anspruch 21, bei der die Dispersion mindesten eine weitere Komponente enthält, die aus nicht elektrisch leitfähigen Komponenten, Komplexbildnern, Viskositätsreglern, Verlaufshilfen, Trocknungshilfen, Glanzverbesserern, Mattierungsmitteln und Mischungen davon ausgewählt ist.

23. Verwendung nach Anspruch 21 oder 22, bei der das Dispersionsmedium Wasser, ein mit Wasser mischbares organisches Lösemittel oder eine Mischung davon enthält.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Fig. 1

